

北京赛微电子股份有限公司

关于与北京市怀柔区人民政府签署《战略合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次签署的《战略合作协议》属于协议各方为开展后续合作所达成的合作原则，具体的合作内容及进度以双方签署的相关正式协议为准。

2、公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司与参股子公司北京赛微私募基金管理有限公司、北京怀胜高科技产业发展有限公司、北京怀柔硬科技创新服务有限公司签署《投资协议》，共同出资设立北京海创微元科技有限公司（以下简称“海创微元”），海创微元即为本次《战略合作协议》约定的项目公司。公司将依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、本次签署的《战略合作协议》涉及对6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台的建设投资，暂时难以预计对公司2024年度经营业绩及未来年度经营业绩所产生的具体影响。如本协议能顺利实施和推进，将有助于推动公司MEMS芯片制造业务的发展、中长期发展战略的实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

4、公司于2021年8月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于控股子公司签署〈战略合作框架协议〉的公告》，公司与武汉怡格敏思科技有限公司、武汉敏声新技术有限公司签署了《战略合作框架协议》，2022年6月17日，基于各方合作开展的实际情况，经友好协商，各方签署了《战略合作框架协议之补充协议》，武汉怡格敏思科技有限公司退出该次战略合作，由武汉敏声新技术有限公司承担其全部权利和义务。

公司于2022年1月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于与合肥高新区管委会签署〈合作框架协议〉的公告》，公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签署了《合作框架协议》，拟在合肥高新区投资建设12吋MEMS制造线项目，后续因公司收购德国汽车芯片制造产线事项被禁止，该协议已实质终止履行。

公司于2022年2月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于控股子公司与北京怀柔经信局签署〈合作协议〉的公告》，公司控股子公司北京海创微芯科技有限公司（以下简称“海创微芯”）与北京市怀柔区经济和信息化局（以下简称“怀柔经信局”）签署了《合作协议》，拟在怀柔科学城建设6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台、先进MEMS工艺设计与服务北京市工程研究中心、8英寸晶圆级封装测试规模量产线，后续因合作方式调整，经协商，双方于2024年4月9日签署了《终止协议》。

公司最近三年披露的合作框架协议中，除上述变更或终止履行外，其余均在正常履行中（具体详见本公告正文）。

5、本次签署《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议的基本情况

（一）协议签署的基本情况

2024年4月10日，公司与北京市怀柔区人民政府（以下简称“怀柔区政府”）签署了《战略合作协议》，各方本着平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的原则，经友好协商，签署本协议。

本事项无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将依据相关法律法规及《公司章程》等文件的有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应的信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次公司与怀柔区政府签署《战略合作协议》，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）协议对方的基本情况

北京市怀柔区政府依托怀柔科学城市建设，建设以实体经济为支撑、与基础研究相适应的现代化产业体系，着力构建以高端科学仪器和传感器产业为核心、新能源和生命科学等为重点的产业发展方向，立足高水平科技自立自强，完善科技创新生态体系，坚持产业布局 and 空间规划协同推进，打造专精特新和隐形冠军企业示范区。

公司与怀柔区政府不存在关联关系。

2022年1月29日，公司控股子公司海创微芯与北京市怀柔区经济和信息化局签署了《合作协议》，该《合作协议》已于2024年4月9日终止。除上述合作外，公司最近三年公司未与怀柔区政府发生类似交易。怀柔区政府信用状况良好，具有充分履约能力。

二、合作背景

1、公司已全面聚焦 MEMS 主业

公司聚焦资源发展 MEMS 主业。公司是全球领先、国际化运营的高端集成电路芯片晶圆制造厂商，也是国内拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业芯片晶圆制造商。公司在国内外拥有多座中试平台及量产工厂，业务遍及全球，服务客户包括国际知名的光刻机、DNA/RNA 测序仪、红外热成像、计算机网络及系统、元宇宙、硅光子、AI 计算、ICT、新型医疗设备巨头厂商以及各细分行业的领先企业，涉及产品范围覆盖了通讯、生物医药、工业汽车、消费电子等诸多应用领域。公司同时正在打造先进的晶圆级封装测试能力，致力于为客户提供从工艺开发、晶圆制造到封装测试的系统化高端制造服务，努力发展成一家立足本土、国际化经营的知名半导体制造领军企业。

2、MEMS 工艺开发与晶圆制造存在紧密关系

MEMS 属于集成电路行业中的特色工艺。公司 MEMS 业务经营采用“工艺开发+代工生产”的模式，MEMS 工艺开发业务是指根据客户提供的芯片设计方案，以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益为目标，利用工艺技术储备及项目开发经验，进行产品制造工艺流程的开发，为客户提供定制的产品制造流程；MEMS 晶圆制造业务是指在完成 MEMS 产品的工艺开发，实现产品设计固化、生产流程固化后，为客户提供 MEMS 产品的批量代工生产服务。

由于公司北京 FAB3（赛莱克斯北京产线）的定位为规模量产线，其并无法完全满足 MEMS 初创设计公司或成熟设计公司所提出的多品种、小批量、高定制的 MEMS 工艺开发及晶圆制造需求，从产业链角度考虑，公司需要在中国境内建设独立自主的 MEMS 中试线，通过提供工艺开发及小批量代工服务，能够更好地为公司旗下的 MEMS 规模量产线储备并导入相应的客户及产品，最终形成可支持“内循环”、兼顾“双循环”的代工服务体系。

3、公司的 MEMS 战略布局与北京怀柔的科学定位相契合

怀柔科学城围绕物质、空间、地球系统、生命、智能等五大科学方向的成果孵化，着力培育科技服务业，新材料、生命健康、智能信息与精密仪器、太空与地球探测、节能环保等高精尖产业，构建“基础设施-基础研究-应用研究-技术开发-成果转化-高精尖产业”的创新链。怀柔科学城产业转化示范区依托怀柔科学城大科学装置和交叉研究平台的核心资源，建设集研发办公、中试生产、科技服务于一体的硬科技产业园区，将老城区空间资源、怀柔科学城的产业辐射、周边的生态环境有机融合，打造最具智慧的一平方公里，树立产城融合新典范，形成高端仪器装备和传感器产业战略高地。

当前，北京市怀柔区正致力于打造“中国创新、服务世界”的高端仪器装备和传感器产业特区，培育产业集群，打造专精特新和隐形冠军企业示范区。基于公司在 MEMS 产业链中的角色和定位，怀柔区政府欢迎公司 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台项目落地怀柔并提供全方位支持。

三、协议的主要内容

甲方：北京市怀柔区人民政府

乙方：北京赛微电子股份有限公司

（一）合作内容

在科学城产业转化示范区建设高水平的 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台，为 MEMS 传感器的设计、制造、测试等环节提供研发支撑能力，带动 MEMS 传感器产业在怀柔区集聚发展。

（二）合作机制

- 1、双方成立工作专班，负责总体协调各项合作项目具体事宜。
- 2、建立长效沟通机制，定期召开会议、座谈会，及时沟通解决合作过程中

遇到的具体问题，共同推进项目顺利实施。

3、组建项目公司，直接投资运营 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台，以及购置或租赁产业空间。

（三）双方权责

1、甲方权责

（1）甲方负责协调产权单位北京怀胜高科技产业发展有限公司，以资产转让或租赁的方式为项目公司提供落地所需的产业空间。

（2）甲方为项目公司的运营、研发等支出提供系列补贴支持和奖励。

2、乙方权责

（1）乙方及旗下子公司主导建设运营 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线，打造 MEMS 传感器设计、制造、集成、测试、应用的中试研发平台，为传感器前沿突破和原创研发等提供有力保障。

（2）乙方主导项目公司作为园区重点产业平台，需向其他研发机构和产业界提供定制服务、技术服务、小批量生产等，培育孵化硬科技企业；负责为项目公司引进国际技术团队，推动研发转化和产业化，解决重点产业“卡脖子”环节或关键工艺流程瓶颈问题。

3、其他支持事项

（1）甲方支持项目公司围绕 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台引入产业链上下游相关优质项目。

（2）甲方在符合法律法规和政策规定前提下，为项目公司国内外人才引进提供支持。

（3）甲方支持项目公司引入或牵头组织高端仪器装备和传感器领域学术会议和产业交流平台；支持项目公司为本地企业提供 MEMS 研发中试等服务，促进本地企业开展前沿技术的研发、成果转化和产业化。

（四）违约责任

（1）甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成违约，一方违约导致合同目的不能实现的，另一方有权解除合同，双方协商解决已发生的支持费用赔偿事宜，本合同自解除通知到达违约方之日起即告解除。因不可抗力导致合同无法继续履行，可免除违约责任。

（2）甲方可根据各级支持政策，在总金额不变的情况下，调整对项目公司

的支持内容，乙方应配合甲方开展相关工作，具体内容双方根据实际情况另行协商。

(3) 乙方承诺自协议签订之日起，五年内享受政策补贴的设备不得迁出怀柔，十年内 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线在怀柔区生产经营。

(五) 协议生效及其他

(1) 本协议是双方长期合作的指导性文件，具备法律效力。本协议合作项目具体内容，根据具体项目另行签订具体项目合作协议，双方的权利义务以具体项目合作协议为准。本协议以外项目及未来新成立项目，双方同意以本协议为原则和基础另行签订协议约定。

(2) 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，合作期五年。合作期满，双方协商确定是否续约。双方同意续约，另行签署合作协议。

(3) 双方严格遵守对此协议的保密，自觉维护对方声誉，对协议所有相关的信息负有保密责任，不得将保密信息擅自泄露给其他第三方或用于本协议目的以外的其他用途。但双方需要按法律法规规章要求，履行信息公开义务的情况除外。

(4) 本协议年度开始计算的时间基点，以协议签订时为准。

(5) 因本协议或履行本协议发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方有权向怀柔区人民法院提起诉讼。

四、对公司的影响

本次签署的《战略合作协议》涉及对怀柔 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台的建设投资，暂时难以预计该协议对公司 2024 年度及未来年度经营业绩所产生的具体影响。如本协议能顺利实施和推进，将有助于推动公司特色工艺芯片制造业务的发展。

布局 MEMS 中试线，有利于公司 MEMS 规模量产线的工艺、客户储备及产品导入，有利于公司更好地满足来自通信、生物医药、工业汽车、消费电子等终端应用市场的 MEMS 工艺开发及晶圆制造需求。

公司本次与怀柔区政府签署《战略合作协议》，拟在怀柔区投资建设 6/8 英寸晶圆 MEMS 中试生产线，旨在充分利用公司与怀柔科学城的优势资源，积极把握半导体产业发展机遇，促进公司特色工艺芯片制造业务的发展。若本次合作后

续能够顺利推进，将有利于进一步提升公司的领先产能，提高公司的专业制造服务能力，满足下游广泛市场应用需求，提高公司的综合竞争实力，将对公司的长远发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、重大风险提示

1、本次签署的《战略合作协议》属于协议各方为开展后续合作所达成的原则，具体的合作内容及进度将根据各方签署的相关正式协议为准，在协议执行中可能存在和发生其他不可预见或无法预期的履行风险；协议涉及6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台的建设投资，暂时难以预计该协议对公司2024年度经营业绩及未来年度经营业绩所产生的具体影响；敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司最近三年披露的公司（含全资/控股子公司）所签署的合作框架协议的进展情况如下：

序号	披露日期	协议各方	协议名称	进展情况
1	2021年8月13日	1、赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 2、武汉怡格敏思科技有限公司 3、武汉敏声新技术有限公司	《战略合作框架协议》	2022年6月17日，各方签署补充协议，怡格敏思退出本次战略合作，武汉敏声承接其全部权利和义务，协议继续履行。
2	2022年1月1日	1、北京赛微电子股份有限公司 2、合肥高新技术产业开发区管理委员会	《合作框架协议》	因外部因素，实质终止履行，双方互不承担违约责任
3	2022年1月29日	1、北京市怀柔区经济和信息化局 2、北京海创微芯科技有限公司	《合作协议》	2024年4月9日，双方签署《终止协议》，互不承担违约责任
4	2022年4月1日	1、赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 2、某国际知名激光雷达厂商及其子公司	《战略合作框架协议》	正常履行中

3、本协议签署前三个月内，公司控股股东、其他持股5%以上股东、董监高持股情况未发生变动（回购注销限制性股票情形除外）。

4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份即将解除限售的情形。截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024年4月10日